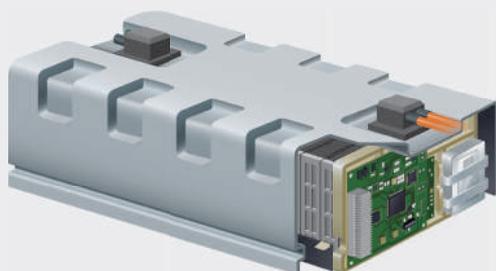


# 基板用非導電銅膏

擁有 20 年以上車載業界使用實績

## 用途

工業用設備，車載應用相關基板（高 Tg）



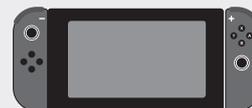
圖：汽車相關應用



家電應用相關基板（高密度線路）

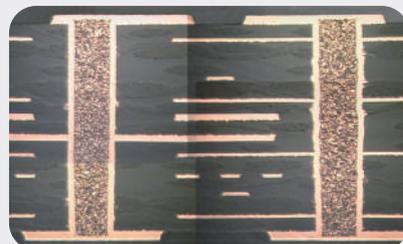


圖：遊戲機



## 主要特性

- 對應各種基材或銅箔都有**良好的密著性**
- 不含溶劑，**可有效壓制空洞的發生**
- 可有效幫助**高密度上件和堆層 (Build-up)** 等相關設計
- 擁有**20 年以上車載業界使用實績**



## 產品型錄和特性表

產品型號			AE1125HD	AE1125DS
金屬粒子	種類		銅粉	
	平均粒徑	μm	5 ~ 6	
結合劑	種類		環氧樹脂	
黏度	BH型	dPa·s	1,200 ~ 2,000	800 ~ 1,600
密度		g/cm <sup>3</sup>	3.7 ~ 3.9	
固化條件	預熱		80°C × 30分	
	完全固化		160°C × 60分	
體積阻抗率		Ω·cm	1.0E+09 ~ 1.0E+12	
熱傳導係數(laser flash method)		W/m·k	1.4	1.1
玻璃轉化溫度		°C	163	210
保存期限	-15 ~ -25°C	月	4	8

